

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

## 厦门华联电子股份有限公司

## 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、担保情况概述

## (一) 担保基本情况

公司全资子公司厦门华联半导体科技有限公司（以下简称“华联半导体”）基于经营发展的需要，拟与客户开展业务合作，公司同意为华联半导体开展该业务合作签署《担保函》。

根据《担保函》中内容约定，公司为华联半导体与客户开展业务过程中形成的全部债权（包含主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等）提供最高不超过 7,500 万元人民币（含）连带责任保证担保，保证期限 6 年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (三) 审议和表决情况

2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：厦门华联半导体科技有限公司

成立日期：2022 年 12 月 14 日

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 100 号恒业楼 208 室-93

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 100 号恒业楼 208 室-93

注册资本：2000 万元

主营业务：半导体器件制造

法定代表人：付智俊

控股股东：厦门华联电子股份有限公司

实际控制人：伍锐

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：73,684,853.9 元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：61,757,007.44 元

2023 年 9 月 30 日净资产：11,927,846.46 元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：83.81%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：83.81%

2023 年 1-9 月营业收入：21,204,828.28 元

2023 年 1-9 月利润总额：-8,262,819.78 元

2023 年 1-9 月净利润：-8,072,153.54 元

审计情况：未审计

注：华联半导体于 2022 年末注册时未实际缴款，故采用 2023 年 9 月 30 日的财务数据。

三、担保协议的主要内容

根据《担保函》中内容约定，公司为华联半导体与客户开展业务过程中形成的全部债权（包含主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的

费用等）提供最高不超过 7,500 万元人民币（含）连带责任保证担保，保证期限 6 年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。其具体担保方式、期限等以签订的担保函为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

华联半导体基于与客户业务合作需要，公司同意为华联半导体提供业务履约的担保，目的是为了推动华联半导体经营发展，有助于华联半导体更好的开展业务和业绩提升。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为华联半导体更好的开展业务，是经营过程中必要的，且有助于公司及华联合半导体的业绩提升，公司对华联合半导体的偿债能力有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于华联半导体业务的稳定、持续合作，不影响其独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

| 项目                           | 金额/万元    | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|----------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 |          |                  |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 7,500.00 | 9.80%            |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      |          |                  |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担         | 7,500.00 | 9.80%            |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 保余额               |  |  |
| 逾期债务对应的担保余额       |  |  |
| 涉及诉讼的担保金额         |  |  |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 |  |  |

六、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司  
董事会  
2023 年 10 月 20 日